

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—9 页
三、附件·····	第 10—13 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 10 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 11 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 12-13 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕6-487号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）管理层编制的截至2026年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伟测科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为伟测科技公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，伟测科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了伟测科技公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年五月八日

上海伟测半导体科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用承销方式，向不特定合格投资者公开发行可转换公司债券1,175万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金117,500.00万元，坐扣承销和保荐费用900.00万元后的募集资金为116,600.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2025年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用301.67万元后，公司本次募集资金净额为116,298.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕6-4号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年3月31日余额	备注
兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	70,000.00		已注销
中信银行上海分行	8110201011501885643	20,000.00		已注销
交通银行上海张江支行	310066865013009418191	26,600.00		已注销
招商银行无锡分行	511903003310018			已注销

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年3月31日余额	备注
交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605			已注销
合计		116,600.00		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 301.67 万元，系公司 2025 年使用自有资金支付保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用所致。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况说明

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2025）6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-030）。

金额单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2025 年 4 月 15 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	58,938.02	58,938.02	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	18,488.01	18,488.01	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日
偿还银行贷款及补充流动资金项目	27,500.00	180.07	180.07	2025 年 5 月 28 日	2025 年 4 月 27 日

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

2. 偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

部分募投项目达到预定可使用状态后尚未构成完整会计年度，故产生效益低于 20%。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年4月15日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品	2025年4月27日	2026年4月26日	2025年4月27日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7天通知	16,600.00	2025/4/30-2025/5/12	0.53
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6-2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3-2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7-2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7-2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8-2025/9/16	0.53

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行 无锡分行 新区支行	7天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86
合 计			87,600.00[注]		61.05

[注]与计划进行现金管理的金额 40,000.00 万元差异系循环购买理财产品所致

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至2026年3月31日，募集专户均已注销，节余募集资金8.17万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



上海伟测半导体科技股份有限公司

二〇二六年五月八日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：116,298.33						已累计使用募集资金总额：116,361.71				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2025 年：116,361.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,000.00	70,000.00	70,018.42	18.42[注 1]	2025 年 9 月
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.00	20,000.00	20,000.10	0.10[注 1]	2024 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	27,500.00	27,500.00	26,343.18	27,500.00	27,500.00	26,343.18	-1,156.82[注 2]	不适用

[注 1]项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致

[注 2]本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决

附件 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	不适用	项目达产后，可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	不适用	项目达产后，可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 2]	32,463.57	是
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价

[注 2] 伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。本期为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预计效益



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

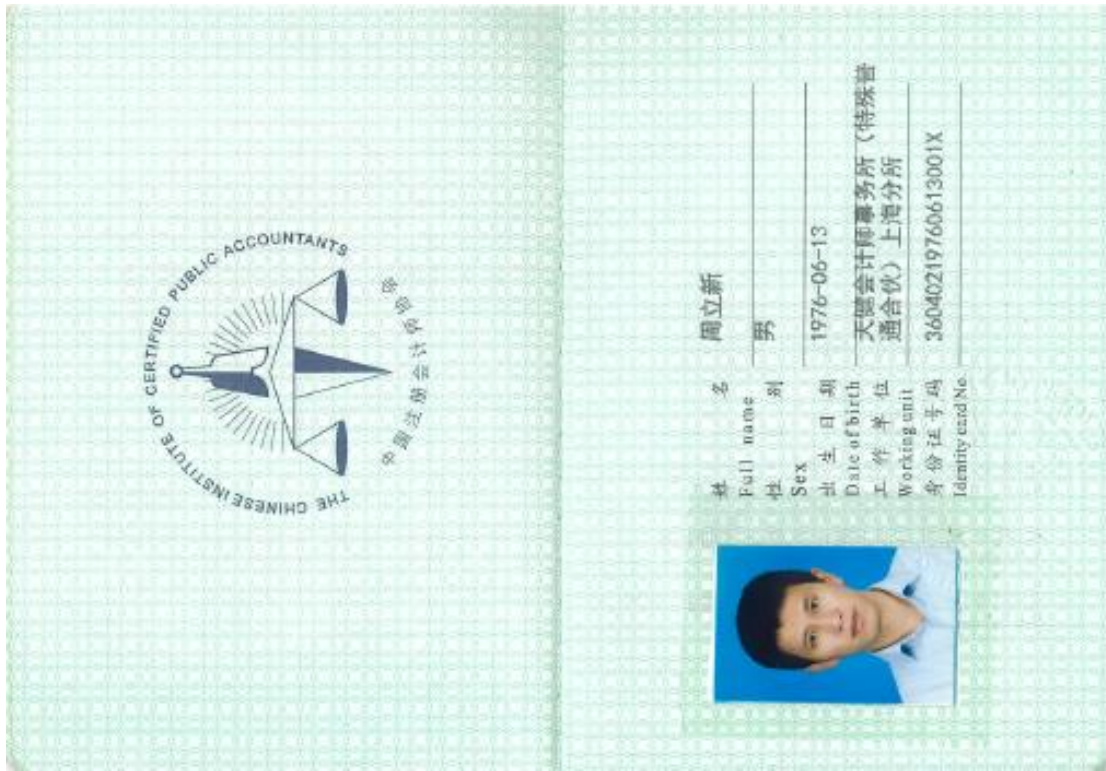
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

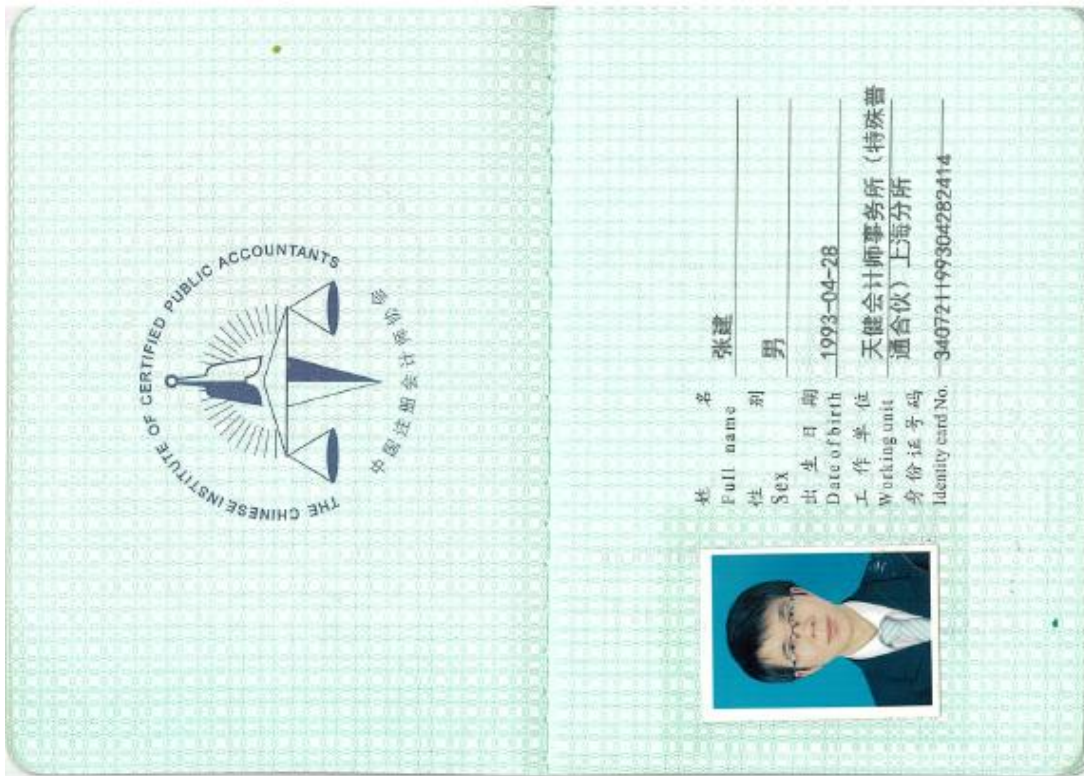
本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-487号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审（2026）6-487号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-487号报告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-487号报告后附之用，证明张建是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。